nanoETCH

Soft-etching system for 2D materials.

ソフトエッチング装置 Model. ETCH5A

2次元材料（グラフェン TMD/TMDC）、PPA・PMMA等のレジスト除去、SiO2, h-BNエッチング

MOORFIELD NANOTECHNOLOGY



（開発元：英国 **Moorfield Nanotechnology Ltd.**）

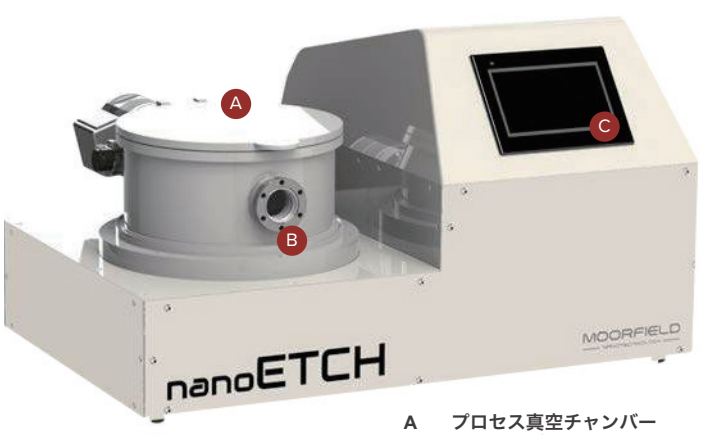
Thermocera

endless possibility_thermal engineering **www.thermocera.com**

email: sales@thermocera.com +81 36214 3033 www.thermocera.com

nanoETCH
(ナノエッチ)

Model. ETCH5A





A　プロセス真空チャンバー
B　フロントビューポート
C　タッチスクリーン
D　外部出力端子
E　ターボ分子ポンプ
F　電源接続口/ヒューズ
G　ガス/冷却水接続

＜30W（制御精度10mW）低出力 RFエッチングによるダメージレスエッチング
英国アカデミックパートナーとの共同開発技術「Soft-Etching」テクノロジー。

英国Moorfield Nanotechnology社の'nanoETCH'ソフトエッチング装置は、繊細で高難易度なエッチング技術を要求される2D材料に対応するローパワー・高精度制御のエッチング装置です。nanoETCHによりクロスリンク、コンタミ、破断・剥離などのリスクを抑えることが可能となります。

【主なアプリケーション】

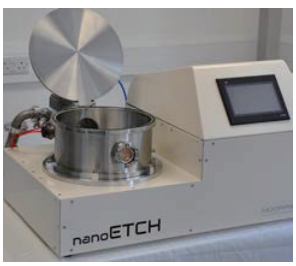
- **2D（遷移金属ダイカルゴゲナイド, グラフェン）**
- **PMMA, PPA等のポリマーレジスト除去**
- **グラフェン、レジスト転写後のテープ残渣除去**
- **h-BNエッチング（*『フッ化ガス供給モジュール』オプション要）**
- **SiO2エッチング（*『フッ化ガス供給モジュール』オプション要）**

【主仕様】	
ウエハーサイズ	Φ3inch（標準）、又はΦ4inch、最大Φ6inch
プロセスガス	最大3系統MFC（Ar, O2標準, N2オプション）
真空排気系	ターボ分子ポンプ、ロータリーポンプ、WRGワイドレンジゲージ
到達真空度	5×10-5Pa
プラズマ電源	RF＜30W 自動マッチングユニット付属
オプション	APC プロセス圧力自動制御パッケージ, DC電源ユニット
	キャパシタンスマノメータ
	フッ化ガス供給モジュール（SF_6, CHF_3）, ドライスクロールポンプ

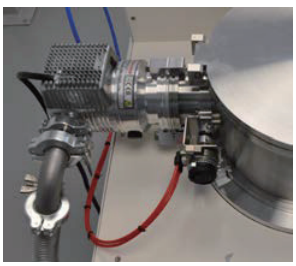
【ユーティリティ】	
電源	200V 単相 30A
プロセスガス	25psi（0.17Mpa） 99.99%推奨
ベントガス	5-6psi（34-41kpa）
冷却水	1L/min ＜4bar（400kpa）, 18-20℃
圧縮空気	60-80psi（413-550Mpa）



nanoETCH
※外形寸法：804(W) x 504(D) x 442(H)mm







左：装置正面 外観

中：Φ3inchステージ

右：ターボ分子ポンプ

Distributor : Japan
Thermocera endless possibility_thermal engineering
〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-2-14 新槇町ビル別館第一 2 階
Tel：03-6214-3033 Fax：03-6214-3035 E-mail：sales@thermocera.com